

1-8-4-17 カーボン回路短絡／碳膏线路的短路 / Short between carbon paste conductors

【特徴】 カーボン回路線間で短絡している状態の欠陥

【特征】 在碳膏线路之间有短路状态的缺陷。

【Characteristics】 Two carbon conductors are shorted here.

【原因・判断ポイント・発生工程】 カーボン印刷時の接触や版の汚れなどにより出来たもの（カーボン印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在碳膏印刷时接触或者网版玷污所引起的（碳膏印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
This type of short is formed by a touch of something to the board in carbon paste printing or a stained printing screen process (Carbon paste printing process)



【コメント】
左カーボンペーストによる微細な汚れによって出来たもの（カーボン印刷工程）
顕微鏡倍率×

【注釋】
碳膏的细微玷污而引起的（碳膏印刷工序）。
显微镜倍率 ×

【Comments】
Caused by fine stain of carbon paste (Carbon paste printing process)
Magnification: ×

1-8-4-18 ビアホールズレ疑似短絡／导通孔偏移的疑似短路 / Quasi short by misaligned via hole

【特徴】 ビアホール下ランドとビアホールの中心にズレがあり、下ランドからはみ出したブラインドビア底部が下側層近くまで伸びている状態の短絡

【特征】 导通盲孔偏离连接盘中心，盲孔底部超出连接盘，延伸到下层的短路。

【Characteristics】 There is a misalignment between a via-hole center and the center of a via-bottom-land. The conductor extended from a blind via bottom land nearly reaches to a lower conductive layer.

【原因・判断ポイント・発生工程】 ビアホール用レーザー穴加工の中心が、ビア下ランドの中心からずれたことにより、レーザー穴がビア下ランド層をつきぬけ次の層近くまで達したため、スルーホール銅めっきがそこまで析出し出来たもの（露光、積層、レーザー穴あけ、スルーホールめっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】 激光加工盲孔时偏离底部连接盘，致使盲孔偏离连接盘延伸到下层，镀铜时在该部位沉积而引起的（曝光、层压、激光钻孔、镀通孔工序）。



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×